

杭州士兰微电子股份有限公司

关于子公司收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）申报的“新增年产 24 万片 8 英寸生产线电力电子器件与功率半导体芯技术改造项目”获得国家发展和改革委员会、工业和信息化部 2017 年集成电路重大项目补助资金 5,000 万元。士兰集昕已于 2017 年 12 月 20 日收到杭州经济技术开发区财政局转拨付的以上 5,000 万元专项资金。

公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）近日收到杭州经济技术开发区经济发展局和财政局联合下发的《关于下达 2015、2016 年国家 02 科技重大专项开发区财政配套资金的通知》（杭经开经[2017]175 号）：士兰集成承担的《惯性传感器、地磁传感器和压力传感器的工艺及封装技术的研发并导入量产》课题获得 2015 年开发区配套资金 357 万元，2016 年开发区配套资金 112 万元，合计 469 万元。士兰集成已于 2017 年 12 月 20 日收到杭州经济技术开发区财政局拨付的以上 469 万元专项资金。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，士兰集昕上述获得的补助资金的类型为与资产相关，计入递延收益。士兰集昕将结合项目进度并根据相关资产的折旧年限将以上补助资金分期计入损益。

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，士兰集成上述收到的补助资金将记入递延收益，其中约有 430 万元与收益相关拟计入当期损益，其余约 39 万元为与资产相关将结合项目进度并根据项目相关资产的折旧年限计入损益。

公司预计上述补助资金不会对公司 2017 年度利润产生重大影响。最终的会计处理以及对公司 2017 年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果

为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017年12月22日